

2025年度微电子所招聘岗位一览表

部门	岗位名称	专业	岗位职责及岗位要求	简历接收邮箱
抗辐照器件技术重点实验室	单元库/IP设计	微电子/集成电路	硕士及以上，博士优先，专业类别覆盖微电子学与固体电子学、集成电路工程、计算机科学与技术等，年龄32岁以下优先，有工作经历优先，熟悉Cadence/Synopsys等平台集成电路设计，有数字标准单元库、数字或模拟IP、ESD防护设计及流片经验优先	gaojiantou@ime.ac.cn
抗辐照器件技术重点实验室	材料工程	微电子/材料工程	硕士及以上，博士优先，专业类别覆盖微电子学与固体电子学、材料科学与工程等，年龄32岁以下优先，熟悉半导体物理、晶圆材料制备工艺、器件制备工艺、材料光/热/电学表征、第一性原理计算等，有相关研究/工作经历优先。	gaojiantou@ime.ac.cn
抗辐照器件技术重点实验室	器件模型开发	微电子/集成电路	硕士及以上，博士优先，熟悉半导体器件物理，能够熟练使用相关器件测试设备及TCAD仿真软件与参数提取软件等，负责先进器件工作机理及模型研究，包含器件极低/高温工作机理研究及阈值电压、迁移率极低/高温解析模型及极低/高温SPICE模型构建等。	gaojiantou@ime.ac.cn
抗辐照器件技术重点实验室	功率集成电路设计	微电子学	<p>岗位职责：主要从事智能功率集成电路设计工作，负责功率集成电路设计、电路仿真、版图设计等工作。对智能功率集成电路项目的进度和质量负责，完成相关文档的撰写</p> <p>岗位要求：</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 微电子等相关专业，硕士及以上学历； 2. 熟练掌握数字集成电路、模拟集成电路、半导体器件等相关知识； 3. 负责完成相关Power IC电路的设计，验证，测试，debug等具体工作 4. 具备独立工作能力，有功率集成电路设计经验者优先 5. 熟悉Cadence Virtuoso 设计仿真环境者优先。 	gaojiantou@ime.ac.cn
抗辐照器件技术重点实验室	存储器设计工程师	微电子学与固体电子学 集成电路	<p>岗位职责：负责先进存储器电路设计、仿真和版图绘制，负责先进存储器电路的可靠性机理研究与加固技术开发，协助开展存储器测试验证向量开发，负责项目研发过程、验收中涉及的存储器电路设计、验证与可靠性技术相关文件资料准备。</p> <p>岗位要求：具备电路设计相关技术能力，能够胜任岗位职责，具备良好沟通协调能力，工作态度严谨，具有相关岗位工作经验。</p>	gaojiantou@ime.ac.cn
抗辐照器件技术重点实验室	存内计算芯片设计工程师	电子科学与技术类、电子与信息类、计算机类	<p>岗位职责：负责存内计算等AI芯片设计开发</p> <p>岗位要求：1、博士；2、具有扎实的微电子专业基础知识，熟练掌握集成电路设计与仿真工具，如cadence、synopsys相关设计仿真软件等；3、具有较丰富的数字域或模拟域存内计算电路设计经验；4、具有良好的英语水平，具备良好的英文文献调研和论文撰写能力；5、具有较强的责任心和良好的沟通能力。</p>	gaojiantou@ime.ac.cn

2025年度微电子所招聘岗位一览表

部门	岗位名称	专业	岗位职责及岗位要求	简历接收邮箱
抗辐照器件技术重点实验室	数字集成电路设计工程师	微电子学与固体电子学 集成电路	<p>岗位职责：负责高可靠数字集成电路电路设计、仿真和验证工作，负责高可靠数字集成电路的可靠性机理研究与加固技术开发，协助开展数字集成电路测试验证向量开发，负责项目研发过程、验收中涉及的数字集成电路电路设计、验证与可靠性技术相关文件资料准备</p> <p>岗位要求：具备电路设计相关技术能力，能够胜任岗位职责，具备良好沟通协调能力，工作态度严谨，具有相关岗位工作经验。</p>	gaojiantou@ime.ac.cn
抗辐照器件技术重点实验室	模拟集成电路设计工程师	微电子学与固体电子学 集成电路	<p>岗位职责：负责高性能模拟集成电路电路设计、仿真和版图绘制，负责高性能模拟集成电路的可靠性机理研究与加固技术开发，协助开展模拟集成电路测试验证向量开发，负责项目研发过程、验收中涉及的模拟集成电路电路设计、验证与可靠性技术相关文件资料准备</p> <p>岗位要求：具备电路设计相关技术能力，能够胜任岗位职责，具备良好沟通协调能力，工作态度严谨，具有相关岗位工作经验。</p>	gaojiantou@ime.ac.cn
抗辐照器件技术重点实验室	射频模拟芯片设计	微电子学与固体电子学	<p>岗位职责：高速接口电路的技术研究与开发工作，承担以下职责一项或者多项：1、进行高速接口电路发射机研究；2、进行高速接口电路接收机研究；3、进行高速接口电路测试相关研究。</p> <p>岗位要求：1、微电子，电子工程等相关专业硕士及以上学历，有相关高速接口电路设计、测试经验者优先；2、具备模拟集成电路、数字集成电路等相关的电路设计基础。3、熟练掌握多种仿真及设计工具，如Cadence/Matlab/ADS/HFSS/Altium Designer等。4、具备独立工作能力和解决问题的能力、善于沟通，乐于合作，热衷新技术，善于总结分享，喜欢动手实践。</p>	gaojiantou@ime.ac.cn
抗辐照器件技术重点实验室	射频芯片设计	电子科学与技术类、信息与电子科学类、电子与信息类、信息与通信工程	<p>岗位职责：独立或带领团队完成硅基射频、毫米波、太赫兹功率放大器、低噪声放大器、频率综合器等无线通信系统模块的设计，攻克关键技术难题，申请相关领域科研项目，发表高水平文章。</p> <p>岗位要求：掌握模拟、射频、混合信号集成电路设计相关知识，熟悉芯片设计流程；博士学位，微电子学与固体电子学及相关专业；具有通信芯片开发经验，且在相关领域具有突出科研成果。</p>	gaojiantou@ime.ac.cn

2025年度微电子所招聘岗位一览表

部门	岗位名称	专业	岗位职责及岗位要求	简历接收邮箱
抗辐照器件技术重点实验室	集成电路测试工程师	电子信息科学技术、测试仪器仪表相关专业	<p>岗位职责：</p> <p>(一)负责高可靠集成电路与元器件测试工作；</p> <p>(二)负责高可靠电子系统研发工作；</p> <p>(三)协助完成研究室安排的各项科研任务。</p> <p>岗位要求：</p> <p>(一)学历要求：本科及以上</p> <p>(二)专业领域：电子信息科学技术、测试仪器仪表相关专业</p> <p>(三)其他条件： 1. 具备良好的电路知识基础； 2. 熟练操作各种常用测试仪器仪表； 3. 具有较强的责任心及团队协作能力。</p>	gaojiantou@ime.ac.cn
感知中心	人工智能芯片设计	计算机及集成电路设计等	<p>岗位职责：</p> <p>1、负责类脑芯片体系架构设计；</p> <p>2、负责类脑芯片RTL设计实现；</p> <p>3、相关科研项目申请。</p> <p>岗位要求：</p> <p>1、硕士及以上学历，计算机及集成电路设计相关专业教育背景；</p> <p>2、具有处理器体系架构设计经验；</p> <p>3、熟悉SNN、神经元等类脑设计技术；</p> <p>4、具备良好的团队协作精神，能够独立解决问题，承担项目责任；</p> <p>6、良好的英语读写能力，能够撰写英文文章；</p> <p>5、在国内外学术或者行业内具有一定影响力。</p>	hehuan@ime.ac.cn
感知中心	数字集成电路设计	微电子，电子科学与技术	<p>岗位职责：</p> <p>1、负责通用高效能处理芯片设计；</p> <p>2、负责RTL设计与验证；</p> <p>3、相关技术文档及科技报告撰写。</p> <p>岗位要求：</p> <p>1、硕士及以上学历，集成电路设计及电子科学与技术相关专业教育背景；</p> <p>2、具有数字集成电路设计经验，熟悉前后端设计流程；</p> <p>3、熟练使用Verilog硬件描述语言及相关EDA工具；</p> <p>4、熟练使用FPGA进行验证；</p> <p>5、具备良好的团队合作精神，能够独立解决问题，承担项目责任；</p> <p>6、良好的英语读写能力，能够撰写英文文章。</p>	hehuan@ime.ac.cn

2025年度微电子所招聘岗位一览表

部门	岗位名称	专业	岗位职责及岗位要求	简历接收邮箱
感知中心	模拟集成电路设计	微电子	<p>岗位职责：</p> <ol style="list-style-type: none"> 负责模拟电路的设计与开发，包括但不限于信号调理、数据转换器等模块； 利用仿真工具（如Cadence Spectre、HSPICE等）进行电路仿真，确保电路设计符合功能与性能要求； 参与芯片的调试与测试，解决芯片在研发过程中遇到的技术难题； 撰写设计文档、测试报告及相关技术文档，确保项目文档的完整性和准确性。 <p>岗位要求：</p> <ol style="list-style-type: none"> 拥有微电子或相关领域的博士学位； 具有模拟集成电路设计经验，熟悉CMOS工艺； 精通模拟电路设计，对信号调理、数据转换等电路有深入理解； 熟练掌握Cadence Virtuoso、MATLAB等EDA工具的使用； 具备良好的团队合作精神，能够独立解决问题，承担项目责任； 良好的英语读写能力，能够撰写英文文章。 	hehuan@ime.ac.cn
感知中心	低功耗集成电路设计	计算机及集成电路设计等	<p>岗位职责：</p> <ol style="list-style-type: none"> 负责通用主控处理器低功耗设计； 负责低功耗SRAM设计； 相关技术文档及科技报告撰写，协助项目申请。 <p>岗位要求：</p> <ol style="list-style-type: none"> 硕士及以上学历，计算机及集成电路设计相关专业教育背景； 具有低功耗集成电路设计经验，熟悉前后端设计流程； 熟练使用Verilog硬件描述语言及相关EDA工具； 熟练使用FPGA进行验证； 具备良好的团队合作精神，能够独立解决问题，承担项目责任； 良好的英语读写能力，能够撰写英文文章。 	hehuan@ime.ac.cn

2025年度微电子所招聘岗位一览表

部门	岗位名称	专业	岗位职责及岗位要求	简历接收邮箱
感知中心	硬件设计工程师	电子、信息、计算机	<p>岗位职责： 1、负责音视频系统PCB原理图及版图设计； 2、负责自研芯片的验证PCB原理图及版图设计； 3、负责元器件选型及layout； 4、相关技术文档及科技报告的撰写。</p> <p>岗位要求： 1、硕士及以上学历，电子、信息、计算机等相关专业教育背景； 2、具有PCB设计以及layout经验； 3、熟悉AD、Candence等PCB设计工具； 4、熟悉SI和PI仿真优先； 5、具备良好的团队协作精神，能够独立解决问题。</p>	hehuan@ime.ac.cn
感知中心	嵌入式软件设计工程师	电子、信息、计算机	<p>岗位职责： 1、负责音视频嵌入式开发； 2、负责音视频等边缘感知解决方案的设计； 3、相关技术文档及科技报告的撰写。</p> <p>岗位要求： 1、硕士及以上学历，电子、信息、计算机等相关专业教育背景； 2、具有Linux平台音视频嵌入式开发经验； 3、精通嵌入式Linux应用开发，有扎实的C/C++语言基础； 4、熟悉音视频编解码、封装、传输基本技术； 5、具备良好的团队协作精神，能够独立解决问题。</p>	hehuan@ime.ac.cn

2025年度微电子所招聘岗位一览表

部门	岗位名称	专业	岗位职责及岗位要求	简历接收邮箱
感知中心	射频集成电路设计工程师	微电子或电磁场与微波技术	<p>岗位职责:</p> <ol style="list-style-type: none"> 设计并实现高性能射频收发芯片; 使用仿真工具进行电路建模与性能评估, 优化设计方案; 参与芯片的测试验证, 协助解决集成阶段的技术问题; 编写详细的设计文档和技术报告, 支持项目文档管理。 <p>岗位要求:</p> <ol style="list-style-type: none"> 拥有微电子或相关领域的博士学位; 具有射频集成电路设计经验, 熟悉CMOS或化合物工艺; 精通射频电路设计, 特别是放大器、混频器、振荡器等核心模块; 能够熟练使用Cadence Virtuoso、ADS或其他EDA工具进行仿真和设计; 具备良好的团队协作精神, 能够独立解决问题, 承担项目责任; 良好的英语读写能力, 能够撰写英文文章。 	hehuan@ime.ac.cn
重点实验室	芯片电路设计、算法博士后以及特别助理研究员	集成电路设计	<p>岗位职责:</p> <ol style="list-style-type: none"> 存储器存算一体技术研究。围绕存储器 (SRAM, 忆阻器等) 存算一体技术的器件、工艺、架构、电路与芯片研究。 器件电路协同设计。围绕新型器件与电路的协同设计方法, 新型器件实验与测试、器件模型与机理研究, 器件可靠性电路协同设计方法学。 新型智能加速芯片设计。面向新型低功耗高效的AI智能加速芯片进行设计, 面向特定应用环境进行高算力低能耗的AI智能加速器芯片设计。 异质集成架构设计。基于新型异质集成方法, 探索多器件、多尺度的新型架构设计与优化方法。 <p>岗位要求:</p> <ol style="list-style-type: none"> 拥有微电子器件研究、电路设计等方面的经验者优先; 具有深厚的微电子学与固体电子学、半导体器件、电路设计背景; 具有良好的人际沟通能力和团队协作能力 	zhangkangwei@ime.ac.cn

2025年度微电子所招聘岗位一览表

部门	岗位名称	专业	岗位职责及岗位要求	简历接收邮箱
重点实验室	新型铁电存储器研究特别研究助理	微电子相关专业	<p>岗位职责：</p> <ol style="list-style-type: none"> 开展新型铁电存储器工艺开发及可靠性优化研究 围绕新型铁电存储器件实验与测试、器件模型与机理研究，器件与电路的协同设计方法开展研究 <p>岗位要求：</p> <ol style="list-style-type: none"> 具备物理学、半导体物理、半导体制造等相关知识背景和追踪国际前沿科研成果的能力，具有方向建设能力 熟练掌握CMOS工艺制造的流程和相关技术； 熟练掌握各类存储器的机理、可靠性及集成等理论知识； 熟练应用相关测试仪器和表征手段等。 	zhangkangwei@ime.ac.cn
重点实验室	新型铁电存储器研究特别研究助理	微电子相关专业	<p>岗位职责：</p> <ol style="list-style-type: none"> 开展新型铁电存储器工艺开发及可靠性优化研究 围绕新型铁电存储器件实验与测试、器件模型与机理研究，器件与电路的协同设计方法开展研究 <p>岗位要求：</p> <ol style="list-style-type: none"> 具备物理学、半导体物理、半导体制造等相关知识背景和追踪国际前沿科研成果的能力，具有方向建设能力 熟练掌握CMOS工艺制造的流程和相关技术； 熟练掌握各类存储器的机理、可靠性及集成等理论知识； 熟练应用相关测试仪器和表征手段等。 	zhangkangwei@ime.ac.cn
重点实验室	新范式智能计算芯片博士后以及特别助理研究员	集成电路设计	<p>岗位职责：</p> <ol style="list-style-type: none"> 基于新原理器件的存储与计算IP，设计新型张量处理芯片以及SoC芯片。 发展基于新原理器件与新型存储/计算IP的行为级模型、构建新原理张量处理架构的系统仿真器。 面向先进智能计算模型，发展新范式计算芯片与系统。 <p>岗位要求：</p> <ol style="list-style-type: none"> 深入理解现有主流张量处理架构（GPU与TPU等）及其智能模型加速的原理与方法； 熟练掌握集成电路设计所需的EDA工具，具有实际SoC流片经验者优先； 具有良好的人际沟通能力和团队协作能力 	zhangkangwei@ime.ac.cn

2025年度微电子所招聘岗位一览表

部门	岗位名称	专业	岗位职责及岗位要求	简历接收邮箱
重点实验室	空间智能计算拓扑自旋轨道矩材料与器件/特别研究助理	物理、材料、信息、电子科学与技术	<p>岗位职责：</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 设计和开发空间智能计算拓扑自旋轨道矩材料与器件； 2. 开展多物理场仿真以实施优化器件； 3. 使用洁净室设施制造设备并执行器件表征测试 <p>岗位要求：</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 拥有高质量外延异质结生长、纳米加工经验及器件制备方面的经验者优先； 2. 具有扎实的半导体物理学或自旋电子学背景； 3. 具有上述应用中磁电和自旋电子器件开发和表征经验； 4. 具有良好的人际沟通能力和团队协作能力 	zhangkangwei@ime.ac.cn
重点实验室	高性能自旋轨道矩存储器制备工程师/特别研究助理	物理、材料、信息、电子科学与技术	<p>岗位职责：</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 设计和开发适用于存储器、逻辑等多种应用的新型电子器件； 2. 开展多物理场仿真以实施优化器件； 3. 使用洁净室设施制造设备并执行器件表征测试 <p>岗位要求：</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 拥有高质量外延异质结生长、纳米加工经验及器件制备方面的经验者优先； 2. 具有扎实的半导体物理学或自旋电子学背景； 3. 具有上述应用中磁电和自旋电子器件开发和表征经验； 4. 具有良好的人际沟通能力和团队协作能力 	zhangkangwei@ime.ac.cn
重点实验室	工艺工程师	电子科学与技术、自动化、微电子学、物理电子学	<p>岗位职责：</p> <ol style="list-style-type: none"> 1、负责激光图形发生器的工艺开发和设备的维护； 2、图形数据处理及数据转换； 3、版图设计及绘制光刻版图。 <p>岗位要求：</p> <ol style="list-style-type: none"> 1、政治面貌与伦理要求：热爱祖国，拥护中国共产党领导；有责任感，服务意识及较强的团队合作精神； 2、学历与知识结构：本科及以上学历微电子相关领域； 3、工作能力：掌握掩模版加工相关流程；熟练运用版图设计软件L-edit；熟悉光学及激光图形发生器工艺开发及简单维护工作； 4、工作态度：有责任心，诚实守信，具有较强的责任心与沟通能力。 	zhangkangwei@ime.ac.cn

2025年度微电子所招聘岗位一览表

部门	岗位名称	专业	岗位职责及岗位要求	简历接收邮箱
高频高压中心	先进氮化物电子器件和电路研究	微电子学； 半导体物理	<p>岗位职责：新结构GaN基功率器件设计与研制；氮化物电力电子材料物理和器件物理研究；宽禁带与超宽禁带器件高温高压与抗辐照可靠性和失效机理研究；高水平英文SCI论文撰写与修改；国家级项目的策划与申请。</p> <p>岗位要求：热衷于科学研究，具备扎实的半导体物理和器件物理基础知识；熟悉功率器件的电学表征方法，界面态/体缺陷分析技术, 以及器件仿真方法；具备较高的科技英语论文撰写能力；具备科研项目的申请经历。</p>	changhudong@163.com
高频高压中心	宽禁带半导体异质集成	微电子学； 半导体物理	<p>岗位职责：GaN、SiC、Ga2O3、金刚石等宽/超宽禁带半导体材料异质集成研究；晶圆键合关键工艺研究；半导体器件异质异构融合技术研究；临时键合与解键合关键工艺研究；高水平英文SCI论文撰写与修改；国家级项目的策划与申请。</p> <p>岗位要求：热衷于科学研究，具备扎实的半导体物理和器件物理基础知识；熟悉键合表征技术；熟悉半导体材料表征与物理机理分析；具备较高的科技英语论文撰写能力；具备科研项目的申请经历。</p>	changhudong@163.com
高频高压中心	GaN微波器件与电路	微电子学； 微波器件与电路， 半导体物理	<p>岗位职责： GaN微波器件设计与研制；掌握氮化物射频器件与电路，物理研究；超高频器件与电路；宽禁带与超宽禁带器件高温高压与抗辐照可靠性和失效机理研究；高水平英文SCI论文撰写与修改；国家级项目申请。</p> <p>岗位要求：热爱科研工作，动手能力强，具备扎实的半导体物理和器件物理基础知识；掌握射频器件与电路测试技术；熟悉电路设计；具备英语论文撰写能力；</p>	changhudong@163.com
高频高压中心	宽禁带功率器件和集成电路工程师	微电子学与 固体电子学、 集成电路	<p>岗位职责：主要负责宽禁带化合物半导体功率器件和集成电路的建模、设计、仿真以及版图绘制，按照需求设计宽禁带化合物集成电路模块，设计器件和电路的测试和验证方案，对器件和电路的特性与可靠性进行分析，撰写设计，验证，测试等相关文档。</p> <p>岗位要求：熟练使用cadence等eda设计工具，硕士及以上学位、电子工程、集成电路、微电子等相关专业，熟悉化合物半导体器件及建模优先、有集成电路设计经验者优先，很强的责任感和强烈进取心。</p>	changhudong@163.com
高频高压中心	模拟IC设计	微电子相关专业	<p>岗位职责：主要从事模数转换器（ADC）技术研究，进行项目申请、方案制定、模块划分、关键电路设计等工作。</p> <p>岗位要求：具有扎实的模数混合集成电路基础、具有通用模数混合电路设计经验、熟悉电路仿真环境及EDA工具（Modelsim/Cadence/Calibre/VCS等）；熟悉数模混合集成电路原理、版图设计；有ADC/DAC、PLL、高速Serdes设计流片经验者优先；有40nm及以下流片经验者优先。</p>	changhudong@163.com

2025年度微电子所招聘岗位一览表

部门	岗位名称	专业	岗位职责及岗位要求	简历接收邮箱
高频高压中心	数字IC设计	微电子相关专业	<p>岗位职责：主要从事模数转换器（ADC）技术研究，进行项目申请、方案制定、模块划分、关键电路设计等工作。</p> <p>岗位要求：掌握数字IC分析和设计方法，能熟练使用相关EDA工具进行电路设计、仿真验证和版图设计，具有实际数字IC设计经验；具有高速高精度数字IC流片经验者优先。</p>	changhudong@163.com
高频高压中心	射频集成电路设计工程师	微电子相关专业	<p>岗位职责：毫米波/太赫兹相关芯片设计与测试、超高速混合信号集成电路设计与测试。</p> <p>岗位要求： 具有硕士及以上学历 熟悉毫米波前端相关芯片设计、测试与应用。 熟练掌握ADS、Cadence等仿真软件 专业技术扎实，了解半导体器件物理。</p>	changhudong@163.com
通信中心	智能芯片研究员	计算机、通信、电子相关专业	<p>岗位职责： 1、研究基于Transformer架构的智能芯片架构，提升模型在端侧的推理效率； 2、发表高水平研究成果； 3、争取国家重大研究课题。</p> <p>岗位要求：1、有智能芯片设计与研究经验；2、发表过高水平论文。</p>	gaoxingyu@ime.ac.cn
通信中心	类脑智能算法研究员	计算机、通信、电子相关专业	<p>岗位职责： 1、研究类脑智能算法及软硬协同优化；2、发表高水平研究成果；3、争取国家重大研究课题。</p> <p>岗位要求： 1、人工智能或类脑智能研究经验；2、发表过高水平论文。</p>	gaoxingyu@ime.ac.cn
通信中心	计算机视觉研究员	计算机、通信、电子相关专业	<p>岗位职责： 1、研究各种复杂场景下的计算机视觉算法，提升模型的精度与鲁棒性等指标；2、发表高水平研究成果；3、争取国家重大研究课题。</p> <p>岗位要求： 1、人工智能算法研究经验；2、发表过高水平论文。</p>	gaoxingyu@ime.ac.cn

2025年度微电子所招聘岗位一览表

部门	岗位名称	专业	岗位职责及岗位要求	简历接收邮箱
通信中心	通信算法方向 博士后	通信与信息 系统/信号 与信息处理 方向	针对智能群体规模大，动态强，通信与控制挑战大、单一通信体制不能满足场景受限下复杂需求的问题，研究多制式自适应联合通信、有线无线融合网络的实时感知与性能优化和大规模分布式通信组网和资源协同调度控制，包括正交时空频调制技术、自适应高性能编码技术、多域索引调制技术、软件定义有线无线融合网络性能优化技术、弹性大规模分布式协同通信与分布式智能系统资源协同调度等关键技术	gaoxingyu@ime.ac.cn
通信中心	AI算法工程师	人工智能、 自动化、电 子工程、计 算机	<p>岗位职责：</p> <ol style="list-style-type: none"> 负责物联网领域的算法研究、实现与性能分析； 课题申报、跟踪及项目管理等工作； 完成领导安排的其他相关任务。 <p>岗位要求：</p> <ol style="list-style-type: none"> 具有全日制博士研究生学历。 对无人系统和硬件安全有较强烈的兴趣，热爱科研探索； 有较好的数理功底，熟悉视觉、通信信号等数据处理算法； 思想端正，沉着稳重，团队协作能力强。 	gaoxingyu@ime.ac.cn
通信中心	通信算法方向 博士后	通信与信息 系统/信号 与信息处理 方向	针对智能群体规模大，动态强，通信与控制挑战大、单一通信体制不能满足场景受限下复杂需求的问题，研究多制式自适应联合通信、有线无线融合网络的实时感知与性能优化和大规模分布式通信组网和资源协同调度控制，包括正交时空频调制技术、自适应高性能编码技术、多域索引调制技术、软件定义有线无线融合网络性能优化技术、弹性大规模分布式协同通信与分布式智能系统资源协同调度等关键技术	lijinhai@ime.ac.cn
通信中心	通感一体化系 统研发与实现	电子与信息 系统/信号 与信息处理 /通信与信 息系统	<p>岗位职责：</p> <ol style="list-style-type: none"> 根据指导从事下一代无线通信、感知、定位及通感一体化技术、智能反射面通信、毫米波/太赫兹通信及AI赋能通信与组网相关研究 开展同感一体化原理样机试验验证 完成相关科研项目研究、实验、仿真、申报、结题等工作，输出高质量论文专利等成果； 协助导师完成实验室建设、设备采购维护、项目申请等相关工作 <p>岗位要求：</p> <ol style="list-style-type: none"> 通信、电子、计算机、数学等相关背景，以下方向优先考虑：6G无线通信、无线定位、通感一体化技术、及AI赋能通信与组网等； 具有扎实的专业背景知识、精通数学英语及熟练掌握至少一门编程语言，熟悉LaTex编辑工具； 具有一定的项目参与经历。 	lijinhai@ime.ac.cn

2025年度微电子所招聘岗位一览表

部门	岗位名称	专业	岗位职责及岗位要求	简历接收邮箱
EDA中心	器件TCAD仿真求解及EDA技术	数学/微电子学与固体电子学/电子工程/物理学/材料学等理工专业	<p>岗位职责：1、开展器件TCAD软件研究与开发工作，包括器件TCAD基础架构、算法设计与优化、软件系统实现等。负责定制化TCAD仿真软件研发；2、协助开展新材料/新器件/新架构下器件TCAD仿真软件原型设计等方向关键技术开发和积累，编写相关文档，撰写论文专利等；3、完成领导交办的其他工作。</p> <p>岗位要求：1、理工类博士研究生毕业，具有丰富的微电子和集成电路领域的专业背景知识；2、原则上年龄不超过45周岁，有主持集成电路相关平台软件研发项目的应聘者可适当放宽年龄限制；3、有在知名科研机构高校或大型企业研发机构等担任教授/副教授或相当岗位的任职经历；4、熟练掌握TCAD仿真软件开发流程及方法；5、对新工艺TCAD研发工作具有创新意识，主动性与团队协作意识</p>	lizhiqiang@ime.ac.cn
EDA中心	器件建模与EDA技术	微电子学与固体电子学/电子工程及相关专业	<p>岗位职责：1. 负责新型工艺的器件物理仿真、器件建模及相关EDA工具模块研发；2. 负责器件模型与集成电路仿真融合关键技术研发；3. 负责新材料和新结构MOS器件电学特性分析及优化。</p> <p>岗位要求：电子类相关专业，博士学历；对半导体器件和工艺有深入的理解，熟悉纳米CMOS集成工艺以及器件模型开发相关技术，具备CMOS器件电学性能分析和优化能力；有半导体器件和工艺研发经验者优先。</p>	lizhiqiang@ime.ac.cn
EDA中心	集成电路系统与工艺协同优化	集成电路/微电子学与固体电子学/电子工程/物理学/材料学等理工专业	<p>岗位职责：1、开展集成电路系统与工艺的协同优化(DTCO/STCO)技术研究，包括电路系统架构与仿真、电路设计、器件与工艺协同优化。2、协助开展晶圆级三维系统电路设计与EDA技术等方向关键技术开发和积累；3、配合新型器件工艺的研发，开展设计协同优化技术研究，编写相关文档，撰写论文专利等；4、完成领导交办的其他工作。</p> <p>岗位要求：1、具有丰富的微电子和集成电路领域的专业背景知识；2、原则上年龄不超过45周岁，有主持系统级集成电路芯片设计项目的应聘者可适当放宽年龄限制；3、有在知名科研机构高校或大型企业研发机构等担任教授/副教授或相当岗位的任职经历；4、熟练掌握大规模系统芯片设计流程及方法；5、对STCO和EDA研发工作具有创新意识，主动性与团队协作意识</p>	lizhiqiang@ime.ac.cn

2025年度微电子所招聘岗位一览表

部门	岗位名称	专业	岗位职责及岗位要求	简历接收邮箱
EDA中心	EDA软件开发工程师	计算机软件与理论、计算机科学与技术、软件工程	<p>岗位职责：</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. EDA/TCAD软件模块开发。 2. EDA/TCAD性能测试与提升。 3. EDA/TCAD开发基础设施的搭建和维护。 4. 学习并掌握制造端EDA软件框架与编程系统。 5. 对制造端EDA/TCAD进行改进与扩展开发。 6. 完成领导交办的其他工作。 <p>岗位要求：</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 有良好的C/C++语言基础，熟悉shell、Python或TCL等脚本编程语言。 2. 熟悉Linux系统的基本操作，熟悉Linux下的软件开发及调试方法。 3. 熟悉常用的数据结构和算法，以及多线程优化等，熟练使用git等版本管理软件。 4. 熟悉基于QT的图形化编程软件开发。 	lizhiqiang@ime.ac.cn
EDA中心	模拟射频集成电路IP核研发	微电子，集成电路设计等	<p>岗位职责：从事电源管理、模数转换和运算放大器等模拟IP核或者低噪放和功率放大器等射频IP核的开发</p> <p>岗位要求：</p> <ol style="list-style-type: none"> 1、具有基于CMOS等硅基工艺开展模拟集成电路设计的经验； 2、熟悉至少一种模拟电路，如LDO, Bandgap, DC-DC, OPAMP, ADC, PLL等；或者熟悉至少一种射频电路，如LNA, PA, VCO等； 3、具有一定的模拟或射频版图经验者优先； 4、实际流片测试成功经验者优先。 	lizhiqiang@ime.ac.cn
EDA中心	器件、互连线建模与仿真科研岗	微电子、材料学、物理学、电子信息类等相关专业	<p>岗位职责：</p> <ol style="list-style-type: none"> 1、开展先进制程器件和电路可靠性的机理研究，包括NBTI/PBTI/HCI/EM等可靠性效应； 2、开展先进工艺器件与电路的可制造性机理及建模技术研究； 3、开展利用人工智能技术在智能建模技术研究。 <p>岗位要求：</p> <ol style="list-style-type: none"> 1、半导体材料、物理、电子等相关专业，对半导体器件和芯片可靠性有深入理解； 2、了解半导体工艺、半导体器件结构和原理，了解器件电学及可靠性测试和分析方法，有芯的失效机理和可靠性建模经验者优先； 3、熟悉Matlab等建模工具，至少掌握Matlab、Verilog-A、Python等一种编程语言； 5、了解机器学习、深度学习等人工智能模型； 6、积极上进，具有高度的责任感和良好的团队协作精神。 	qinzhao@ime.ac.cn

2025年度微电子所招聘岗位一览表

部门	岗位名称	专业	岗位职责及岗位要求	简历接收邮箱
EDA中心	AI算法研究科研岗	计算机科学、数学、统计学等相关专业	<p>岗位职责：</p> <ol style="list-style-type: none"> 结合课题组研究方向，承担机器学习、深度学习、强化学习等人工智能算法的研究与设计。 对算法模型进行持续优化，提升模型的准确性、效率和稳定性。 与课题组成员密切协作，提供专业技术支持，推动课题组整体技术能力的提升。 <p>岗位要求：</p> <ol style="list-style-type: none"> 计算机科学、数学、统计学等相关专业，博士及博士后优先考虑。 熟练运用 Python、C++ 等编程语言，熟悉 TensorFlow、PyTorch 等主流深度学习框架，深入掌握 CNN、RNN、Transformer 等机器学习、深度学习算法原理。 具备实际 AI 项目开发经验者优先。 积极上进，具有高度的责任感和良好的团队协作精神。 	qinzhaoahui@ime.ac.cn
设备中心	光学系统研发人员、光学工程师	光学、物理学、精密仪器及相关专业	<p>岗位职责： 半导体光学微纳制造和测量技术研发与仪器研制。具体可包括：</p> <ol style="list-style-type: none"> 精密光学仪器系统的设计、 光学仪器光学结构设计、 光学仪器平台的搭建、实验、系统集成和数据分析、 原理研究和仿真等。 <p>岗位要求：</p> <ol style="list-style-type: none"> 光学、物理学、精密仪器及相关专业； 具有物理光学、精密仪器相关实验经历者优先； 善于沟通，良好协调能力和团队合作精神。 	yuanyan@ime.ac.cn
设备中心	微系统研发、微机电系统研发技术研究员	MEMS、集成电路及相关专业	<p>岗位职责：</p> <ol style="list-style-type: none"> MEMS器件研发与电路开发； CMOS-MEMS设计研究； <p>岗位要求：</p> <ol style="list-style-type: none"> MEMS、微电子等相关专业； 有责任感、思维活跃、沟通能力强，能够独立分析和解决问题的能力； 良好的英文能力和文献调研阅读能力； 具备独立完成设计投片及检测的工作经验； 985院校或双一流专业毕业，有海外求学经历者优先。 	yuanyan@ime.ac.cn

2025年度微电子所招聘岗位一览表

部门	岗位名称	专业	岗位职责及岗位要求	简历接收邮箱
设备中心	算法模型工程师	计算机软件相关专业	<p>岗位职责：</p> <ol style="list-style-type: none"> 参与系统设计的总体规划，方案设计，包括需求分析、项目可行性分析，定义产品功能、软件开发等。 参与数据模型体系构建及相关数据项目：参与数据仓库或大数据平台逻辑数据模型的设计，确保模型的实用性和可扩展性。 负责数据模型的开发、评估和实施：从业务需求出发，进行数据采集、清洗、特征构造、模型训练、测试及评估，最终实施到生产环境中。 协调梳理业务需求，整理业务逻辑：负责与业务部门沟通，理解业务需求，并将其转化为具体的数据模型设计要求。 参与客户沟通对接：与客户沟通，了解需求，及时调整数据模型以适应业务变化。 完成领导分配的其它任务。 <p>岗位要求：</p> <ol style="list-style-type: none"> 计算机、软件工程、微电子、自动化等相关专业博士及以上学历； 熟悉常用的数据库如MySQL、Oracle等，并能熟练使用SQL进行数据操作； 熟练使用数据分析工具如Python、R等进行数据处理和模型开发； 有相关半导体装备、生产工艺模型开发经验者优先； 对机器学习与人工智能有工作经验者优先； 熟悉工控组态软件开发者优先； 具有非标设备自动化软件设计经验者优先。 	yuanyan@ime.ac.cn
设备中心	激光加工工艺工程师	物理、光学、光学工程、微电子、半导体、材料等相关专业	<p>岗位职责：</p> <ol style="list-style-type: none"> 参与半导体晶圆激光加工工艺的研发，在相关设备开发、制造过程中提供技术支持； 能够独立地进行工艺和设备开发过程中的实验研究和数据分析，并基于实验结果提出改进方案。 主要负责国内基地产线激光设备交付，工艺调试、优化及异常解决、工艺培训及产线运维技术支持 <p>岗位要求：</p> <ol style="list-style-type: none"> 光学、光学工程、电子学等相关专业，博士学历优先 从事材料激光加工工艺2年以上工作经验 熟悉激光原理，了解激光加工系统的设计原理和基本结构，对激光微米纳米加工工艺和设备较为熟悉，尤其是应用于晶圆划片的相关加工工艺和设备； 有较好的动手能力，学习能力和沟通协调能力 	yuanyan@ime.ac.cn

2025年度微电子所招聘岗位一览表

部门	岗位名称	专业	岗位职责及岗位要求	简历接收邮箱
设备中心	软件算法工程师	计算机软件相关专业	<p>岗位职责：</p> <ol style="list-style-type: none"> 1、参与系统设计的总体规划，方案设计，包括需求分析、项目可行性分析，定义产品功能、软件开发等。 2、根据项目要求完成软件代码的详细设计、编写、集成与测试、发布，并对使用人员进行培训。 3、参与客户的系统软硬件平台的安装搭建与实施工作。 4、参与技术跟踪，对新产品软件部分进行可行性分析。 5、参与指导、协助编制用户手册。 6、完成领导分配的其它任务。 <p>岗位要求：</p> <ol style="list-style-type: none"> 1、计算机、软件工程、机械、自动化等相关专业本科及以上学历，； 2、熟悉C#编程语言,winform开发平台，有自动化相关行业工作经验，有工控软件开发经验； 3、熟悉软件人机界面开发，熟悉通讯协议等； 4、有相关半导体装备、生产成套设备设计开发经验者优先； 5、对图像处理与计算机视觉有工作经验者优先； 6、熟悉工控组态软件开发者优先； 7、具有非标设备自动化软件设计经验者优先。 	yuanyan@ime.ac.cn
设备中心	电气工程师	电气相关专业	<p>岗位职责：</p> <ol style="list-style-type: none"> 1、负责设备的电气控制系统方案设计； 2、负责设备电气控制系统硬件部署、调试、测试； 3、提出控制调试软件需求，与软件工程师协同完成代码实现； 4、负责电气系统的现场安装和系统调试。 5、负责上位软件接口对接及合作开发。 6、负责设计文档编写归档。 <p>岗位要求：</p> <ol style="list-style-type: none"> 1、机械电子、传感与检测、自动化、控制工程、数学专业本科及以上学历； 2、2年以上运动产品相关行业工作经验，或具有相关项目经验的优秀应届硕士毕业生； 3、良好的控制理论基础，扎实的数学功底； 4、具有机器人，运动控制，无人机，运动台等MIMO系统设计调试经验； 5、熟练掌握MATLAB工具，熟悉C语言及控制算法实现； 6、精通MATLAB/Simulink，用MATLAB仿真模型，或其他基于模型设计工具及C/C++/HDL/Script代码生成工具者优先； 7、熟悉VME/PLC/PMAC/ACS等控制系统。 	yuanyan@ime.ac.cn

2025年度微电子所招聘岗位一览表

部门	岗位名称	专业	岗位职责及岗位要求	简历接收邮箱
设备中心	机械设计工程师	机械设计相关专业	<p>岗位职责：</p> <ol style="list-style-type: none"> 负责设备整体设计及优化； 熟悉机械设计原理，零件加工，了解产品工艺流程和技术标准； 负责机械零部件装配图及零部件图，生成BOM表和设计报告； 熟悉非标自动化设备机械方案设计，机械结构、部件设计、元器件选型； 与电气工程师、机器视觉工程师配合完成整机设备设计； 负责关键尺寸，行程，力，热，刚度、强度等性能校核； <p>岗位要求：</p> <ol style="list-style-type: none"> 机械设计与制造或相关专业毕业，大学本科及以上学历； 熟悉使用2D和3D制图软件，如AutoCAD/Solidworks/PROE等； 熟悉机械原理与设计、分析；熟悉机械加工与装配工艺；熟悉常用机械材料；能独立开发与设计机械零部件及工装夹具； 有光机电一体化设备设计经验者优先，有设备安装与调试经验者优先； 工作认真负责，严谨细致，有良好的创新精神和团队精神； 	yuanyan@ime.ac.cn
封装中心	晶圆级键合技术研发	材料学、微电子学、机械自动化、物理学或其他相关专业	<p>岗位职责：</p> <ol style="list-style-type: none"> 负责W2W或D2W晶圆级键合前瞻技术的研发或成套技术开发； 负责研发项目立项、技术方案制定、开发计划制定、组建开发团队，以及项目的日常管理、各种技术的总结、归类和存档； 负责与各站工艺工程师的日常工作协调，解决技术开发中出现的各种问题。 <p>岗位要求：</p> <ol style="list-style-type: none"> 微电子、材料、物理等相关专业，博士学历，1-2年相关技术经验； 熟悉晶圆级封装工艺、2.5D/3D集成技术； 具有晶圆级键合技术工艺或设备研发经验优先。 	yinwen@ime.ac.cn
封装中心	晶圆级键合设备工程师	机械、自动化、机电或其他相关专业	<p>岗位职责：</p> <ol style="list-style-type: none"> 负责W2W或D2W晶圆级键合设备关键模块研究； 负责研发项目工艺方案制定与验证，以及相关设备的日常管理、维护和作业指导； 负责解决晶圆级键合工艺开发中出现的各种设备问题。 <p>岗位要求：</p> <ol style="list-style-type: none"> 机械、自动化、机电等相关专业，硕士及以上学历，2年以上相关技术经验； 具有晶圆级键合技术工艺或设备研发经验优先。 	yinwen@ime.ac.cn

2025年度微电子所招聘岗位一览表

部门	岗位名称	专业	岗位职责及岗位要求	简历接收邮箱
封装中心	化学气相沉积(PECVD)工艺工程师	材料学、化学、微电子学、物理学或其他相关专业	<p>岗位职责：</p> <ol style="list-style-type: none"> 负责化学气相沉积工艺技术开发； 负责研发项目工艺方案制定与验证，以及相关设备的日常管理、维护和作业指导； 负责解决化学气相沉积工艺开发中出现的各种问题。 <p>岗位要求：</p> <ol style="list-style-type: none"> 化学、微电子、材料、物理等相关专业，本科及以上学历，2年以上相关技术经验； 熟悉晶圆级封装工艺、2.5D/3D集成技术； 具有化学气相沉积工艺或设备研发经验优先。 	yinwen@ime.ac.cn
封装中心	晶圆减薄与划片工艺工程师	材料学、机械自动化、化学、微电子学、物理学或其他相关专业	<p>岗位职责：</p> <ol style="list-style-type: none"> 负责晶圆减薄与划片工艺技术开发； 负责研发项目工艺方案制定与验证，以及相关设备的日常管理、维护和作业指导； 负责解决晶圆减薄与划片工艺开发中出现的各种问题。 <p>岗位要求：</p> <ol style="list-style-type: none"> 材料学、机械自动化、化学、微电子学、物理学等相关专业，硕士及以上学历，1-2年相关技术经验； 熟悉晶圆级封装工艺、2.5D/3D集成技术； 具有晶圆减薄与划片工艺或设备研发经验优先。 	yinwen@ime.ac.cn
封装中心	晶圆湿法刻蚀与清洗设备操作员	化学、材料、机械、电子、机电一体化等相关专业	<p>岗位职责：</p> <ol style="list-style-type: none"> 负责晶圆湿法刻蚀与清洗设备的操作、维护和日常管理等； 负责项目中工艺方案的实施与验证； 协助解决晶圆湿法刻蚀与清洗工艺开发中出现的各种问题。 <p>岗位要求：</p> <ol style="list-style-type: none"> 化学、材料、机械、电子、机电一体化等相关专业，大专及以上学历，1-2年相关技术经验； 熟悉半导体、集成电路相关工艺和设备； 具有半导体或电子行业相关经验，有晶圆湿法刻蚀与清洗设备从业经验者优先。 	yinwen@ime.ac.cn

2025年度微电子所招聘岗位一览表

部门	岗位名称	专业	岗位职责及岗位要求	简历接收邮箱
封装中心	先进软磁材料研发	微电子学与固体电子学/物理学/材料学等理工专业	<p>岗位职责：</p> <ol style="list-style-type: none"> 负责高频金属粉芯、铁氧体等软磁材料研发； 负责片上磁集成工艺研发； 负责片上电感器、变压器设计与优化。 <p>岗位要求：电子类相关专业；对电源类软磁材料和制备工艺有深入理解，熟悉片上磁集成工艺与磁材料物性表征方法，具备磁器件与材料性能协同优化能力。</p>	yinwen@ime.ac.cn
封装中心	AI电源管理芯片设计	微电子学与固体电子学及相关专业	<p>岗位职责：</p> <ol style="list-style-type: none"> 负责片上电源拓扑研发； 负责LDMOS、驱动、控制等电源管理芯片研发。 <p>岗位要求：电子类相关专业；对常用电源管理芯片设计环境与工艺制程有深入了解，熟悉常用片上集成电容材料、性能与工艺流程，具备芯片电热性能协同优化与测试能力；有28nm等先进制程芯片研发经验者优先。</p>	yinwen@ime.ac.cn
封装中心	AI电源模块设计	电力电子学及相关专业	<p>岗位职责：负责电源模块拓扑与控制技术研发。</p> <p>岗位要求：电力电子类相关专业；对同步降压、LLC等常用拓扑结构及其控制方法有深入了解，熟悉高密度电源模块集成工艺与散热结构，具备电路设计与封装结构协同优化与测试能力；有微模块电源研发经验者优先。</p>	yinwen@ime.ac.cn
封装中心	功率模块集成工艺研发	微电子学与固体电子学/物理学/材料学/电力电子学等理工专业	<p>岗位职责：负责功率模块集成工艺研发。</p> <p>岗位要求：电子或材料类相关专业；对MOSFET、GaN等高频功率器件有深入了解，熟悉SMT、铜带键合、烧结等常用工艺流程，具备PCB版图设计能力；有微模块电源研发经验者优先。</p>	yinwen@ime.ac.cn
封装中心	无机非金属材料研发	材料科学与工程及相关专业	<p>岗位职责：无机非金属材料薄膜材料开发；玻璃表面金属化工艺开发；完成项目规定的科研任务。</p> <p>岗位要求：博士，材料类、化学类等相关专业</p>	yinwen@ime.ac.cn
封装中心	材料工程师	材料类、化学类等相关专业	<p>岗位职责：开展封装材料物性表征测试及分析；开展封装材料验证、开发、改性、配方开发等工作；</p> <p>岗位要求：硕士，材料类、化学类等相关专业</p>	yinwen@ime.ac.cn

2025年度微电子所招聘岗位一览表

部门	岗位名称	专业	岗位职责及岗位要求	简历接收邮箱
封装中心	玻璃基板研发	电子工程、微电子、通讯、机械电子、高分子材料等相关专业	<p>岗位职责：</p> <ol style="list-style-type: none"> 1、负责玻璃基板工艺技术研发； 2、负责玻璃基板裂纹、可靠性等关键问题研究； 3、负责项目申请与研发任务； <p>岗位要求：</p> <ol style="list-style-type: none"> 1、博士学历，微电子、材料、物理化学等相关专业，具备电子封装技术可靠性、半导体工艺等知识； 2、熟悉激光诱导玻璃改性设备及工艺者优先； 3、有微组装、PCB，半导体相关行业从业经验者优先。 	yinwen@ime.ac.cn
封装中心	化学分析实验师	化学类、材料类	<p>岗位职责：</p> <ol style="list-style-type: none"> 1、负责化铜电镀药水的分析； 2、协助化铜电镀设备作业和金属化工艺开发； 3、协助工艺工程师解决化铜电镀工艺问题； 4、完成相应的生产管理； 5、完成领导交办的其他任务。 <p>岗位要求：</p> <ol style="list-style-type: none"> 1、本科学历，化学类相关专业； 2、有两年以上PCB相关设备使用经验，或化学分析从业经历； 3、有良好的流程规范遵守意识，承受能力强，有较好的职业道德和团队精神； 4、熟练掌握Office系列软件的使用。 	yinwen@ime.ac.cn

2025年度微电子所招聘岗位一览表

部门	岗位名称	专业	岗位职责及岗位要求	简历接收邮箱
封装中心	维修工程师	物理学类、材料类、机械电子类等	<p>岗位职责：</p> <ol style="list-style-type: none"> 1、负责实验室超净环境相关事宜，保障安全实验、生产； 2、负责实验室基建、技术改造、配套设施二次配，新设备进厂相关事宜； 3、负责实验室设备定期维护、维修工作； 4、协助部分工艺的作业，协助工艺工程师的工艺开发。 5、完成相应的生产管理； 6、完成领导交办的其他任务。 <p>岗位要求：</p> <ol style="list-style-type: none"> 1、本科及以上学历，机械、电子、自动化等相关专业，具备电工证； 2、有两年以上PCB相关设备使用、维修经验，PLC故障维修经验； 3、有良好的流程规范遵守意识，承受能力强，有较好的职业道德和团队精神； 4、熟练掌握Office系列软件的使用。 	yinwen@ime.ac.cn
封装中心	先进封装集成设计工程师	电子工程、微电子、通讯等相关专业	<p>岗位职责：</p> <ol style="list-style-type: none"> 1、开展基于混合键合的超高密度封装设计工作，包括通道布局规划、通道性能评估、版图设计和系统仿真等。 2、协助开展垂直供电架构设计和仿真，编写相关文档，撰写论文专利等； 3、配合设计流程和规则的建立； 4、完成领导交办的其他工作。 <p>岗位要求：</p> <ol style="list-style-type: none"> 1、理工类硕士研究生及以上毕业，具有微电子和集成电路领域的专业背景知识； 2、原则上年龄不超过35周岁，有主持大规模集成电路设计项目的应聘者可适当放宽年龄限制； 3、知名科研机构和高校的应届毕业生，具有微电子和集成电路领域的项目经验； 4、了解先进封装工艺流程，熟练掌握3DIC流程及方法； 5、对先进封装设计工作具有创新意识，主动性与团队协作意识 	yinwen@ime.ac.cn

2025年度微电子所招聘岗位一览表

部门	岗位名称	专业	岗位职责及岗位要求	简历接收邮箱
封装中心	三维异质异构集成可靠性研发工程师	微电子学与固体电子学/力学/材料学等相关专业	<p>岗位职责：</p> <ol style="list-style-type: none"> 负责异质异构集成设计、可靠性测试及应用环境相关的热力、热湿力、电磁热、流体力等多物理场耦合仿真及优化； 负责异质异构集成关键界面可靠性优化与评价，提出界面优化策略并制定相应评价方法、规范及标准； 负责异质异构集成系统诊断与健康管理； 负责相关项目申报、管理、结题等事务性工作； 完成领导安排的其他工作。 <p>岗位要求：</p> <ol style="list-style-type: none"> 拥有丰富的有限元理论基础和仿真软件开发经验； 熟悉混合键合、晶圆级封装工艺和异质异构集成工艺； 电子类、工程类、材料类等相关理工专业，博士学历； 对集成电路及异质异构集成有深入理解，拥有新产品研发经验者优先。 	yinwen@ime.ac.cn
封装中心	微系统技术工程师		<p>岗位职责：</p> <ol style="list-style-type: none"> 负责先进微系统的结构仿真设计、器件选型、材料验证、工艺开发、性能测试等； 负责相关项目的材料撰写以及项目推进等工作； 参与项目组中先进传感器的设计与工艺开发； 配合项目组完成相关项目的申请、推进以及结题等工作； 完成领导交办的其他工作。 <p>岗位要求：</p> <ol style="list-style-type: none"> 具备MEMS器件、电子材料、系统热设计、电路系统等开发项目经验优先； 具备MEMS工艺集成能力、特殊工艺开发能力优先； 熟悉芯片封装、测试技术，精通Ansys、COMSOL等力、热、电等物理场仿真； 年龄30岁以下优先，硕士及以上。 	mems@ime.ac.cn

2025年度微电子所招聘岗位一览表

部门	岗位名称	专业	岗位职责及岗位要求	简历接收邮箱
封装中心	微系统技术特别研究助理	电子信息	<p>岗位职责：</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 独立开展微系统的设计、散热、工艺、电路、测试等领域研究； 2. 负责相关项目的材料撰写、项目争取以及项目推进等工作； 3. 配合项目组完成相关项目的申请、推进以及结题等工作； 4. 完成领导交办的其他工作。 <p>岗位要求：</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 获得或即将获得博士学位，年龄35周岁以下，英文表达与写作熟练； 2. 具有较强的科研动力、开放的学习态度、良好的沟通能力和团队协作精神； 3. 具有材料、机械、传热、电子器件等领域背景。 	mems@ime.ac.cn
先导中心	纳米CMOS器件及集成工艺研发	微电子学与固体电子学及相关专业	<p>岗位职责：1. 负责CFET器件关键工艺、集成技术研发；2. 负责高迁移率沟道器件、异质CFET等新型器件及集成技术研发；3. 负责纳米器件电学特性测试分析及优化；4. 参与相关科研项目申请、报告、结题等工作。</p> <p>岗位要求：电子类相关专业，硕士及硕士以上学历；工作态度认真负责，做事积极主动，具有较强沟通、学习和动手能力，工作认真负责、善于学习、具有良好的团队合作精神；对半导体器件和工艺有深入的理解，熟悉纳米CMOS集成工艺，具备CMOS器件电学性能分析和优化能力；有半导体器件和工艺研发经验者优先。</p>	icachr@ime.ac.cn
先导中心	三维逻辑器件及源漏工程技术研发	微电子与固体电子学、材料科学与工程	<p>岗位职责：负责单片CFET器件垂直源漏选择性外延生长与缺陷抑制机理研究，设计和优化集成工艺流程，完成源漏外延质量提升与应力调控优化，实现CFET器件源漏电阻降低与器件性能提升。</p> <p>岗位要求：1. 具有半导体器件与工艺研究经历，熟悉先进集成电路器件与工艺进展；2. 具有外延相关工艺经验优先；3. 硕士及以上学历。</p>	icachr@ime.ac.cn
先导中心	三维逻辑器件及阈值调控技术研发	微电子与固体电子学、材料科学与工程	<p>岗位职责：负责新型偶极子阈值调控材料、技术与内在机理研究，设计和优化集成工艺流程，完成GAA/CFET中调控优化，实现电路应用。</p> <p>岗位要求：1. 具有半导体器件与工艺研究经历，熟悉先进集成电路器件与工艺进展；2. 具有ALD、阈值调控相关工艺经验优先；3. 硕士及以上学历。</p>	icachr@ime.ac.cn
先导中心	三维逻辑器件及集成工艺研发	微电子与固体电子学、集成电路工程	<p>岗位职责：负责GAA/CFET器件高密度集成工艺研发，完成精细图形定义与结构形成的关键工艺与集成技术开发，结合DTCO技术，实现三维器件的合理布局，在单位面积内实现GAA/CFET器件的高密度集成。</p> <p>岗位要求：1. 具有半导体器件与工艺研究经历，熟悉先进集成电路器件与工艺进展；2. 具有光刻和刻蚀等相关工艺经验优先；3. 硕士及以上学历。</p>	icachr@ime.ac.cn

2025年度微电子所招聘岗位一览表

部门	岗位名称	专业	岗位职责及岗位要求	简历接收邮箱
先导中心	CMOS器件研发及仿真计算	微电子学与固体电子学、集成电路相关专业	<p>岗位职责：1. 负责集成电路前沿技术的调研分析；2. 负责垂直沟道GAA、CFET等先进逻辑器件的研发；3. 负责CMOS器件电学特性测试分析与优化；4. 负责相关科研工作的数据分析总结以及科研项目申报结题等工作。</p> <p>岗位要求：1. 具备扎实的半导体器件物理和集成工艺知识；2. 具备良好的英语听说读写能力；3. 具有半导体器件、工艺研发和设计制造经验者优先。</p>	icachr@ime.ac.cn
先导中心	工艺开发与整合工程师	电子科学与技术类、电子信息、物理化学材料等专业类	<p>岗位职责：1. 负责面向先进逻辑器件的工艺开发和整合；2. 负责先进CMOS器件的工艺集成和流片；3. 负责工艺开发过程中的表征测试分析。</p> <p>岗位要求：1. 专业知识扎实，了解半导体器件，先进集成电路工艺制程；2. 具备良好的英语听说读写能力；3. 具有半导体器件、工艺研发和设计制造经验者优先。</p>	icachr@ime.ac.cn
先导中心	先进逻辑器件可靠性研究	集成电路工程、信息与电子科学、物理、电子科学与技术等	<p>岗位职责：1. 开展FinFET、GAA等先进逻辑器件的可靠性表征与机理分析工作；2. 开展先进逻辑器件的失效分析工作；3. 完成项目申报、执行和结题的部分技术总结工作；4. 协助指导硕士/博士研究生；</p> <p>岗位要求：1. 微电子相关专业，博士学历，具备扎实的半导体器件物理和集成工艺基础；2. 熟悉FinFET、GAA等先进逻辑器件的工艺集成技术；3. 具有良好的英语听说读写能力；4. 具有半导体器件测试相关经验者优先；</p>	icachr@ime.ac.cn
先导中心	键合/光刻等工艺研发工程师	材料学、微电子学、化学、物理学或其他相关专业	<p>岗位职责：</p> <p>(1) 工艺研发：主要负责先进逻辑制程HKMG、EPI、Metal、CVD、刻蚀、湿法、高温、光刻、CMP、离子注入等模块工艺的开发；</p> <p>(2) 与工艺整合工程师合作进行工艺流程搭建、维护及优化，提高器件良率、工艺窗口等；</p> <p>(3) 参与工艺流片，负责模块工艺实验设计、结构和性能分析，进行流片数据处理及内外部资源的沟通协调。</p> <p>岗位要求：</p> <p>1、工作态度认真负责，积极主动，有较强的学习、创新和沟通协调能力；</p> <p>2、能熟练查找阅读分析中英文文献，有自主分析解决问题的能力；</p> <p>3、深刻理解工艺集成及半导体器件相关知识，具有3年以上先进制程工作经验；</p> <p>4、学历硕士以上，年龄35岁以下优先，微电子与固体电子学类、物理学类、材料科学与工程类、化学类等工科专业。</p> <p>5、良好的口语和书面英语交流能力。</p>	icachr@ime.ac.cn

2025年度微电子所招聘岗位一览表

部门	岗位名称	专业	岗位职责及岗位要求	简历接收邮箱
先导中心	净化间操作人员	电子、机械、信息技术相关	<p>岗位职责：负责净化间各工艺模组相关设备的日常操作及简单维护，熟练掌握相关设备的工艺操作要求，按时完成各项生产、实验任务。按期完成各项QC、PM作业，保证工艺、设备的稳定性。负责本组相关的生产辅助工作和6S。</p> <p>岗位要求： 1. 积极主动，认真细致。2. 学习能力、实际动手能力强。3. 具有团队合作意识。4. 能适应净化间环境和倒班工作。5. 应届毕业生优先。</p>	icachr@ime.ac.cn
先导中心	薄膜设备工程师	机电相关专业	<p>岗位职责： 1. 薄膜设备维护、维修：依据设备规范及时进行设备的维护及保养工作，保障设备稳定运行。 2. 设备维修：对设备出现的故障及时维修处理，提升设备uptime。 3. 设备备件采购：定期检查易耗件库存并提前采购，做好costdown。 4. 兼任部门安全员，负责设备相关区域6S。定期进行安全巡检，及时排除安全隐患，出现安全事故按照应急流程及时进行处理。 5. 设备相关的质量文件完善、编制、培训。</p> <p>岗位要求： 1. 工作态度认真负责，积极主动，有较强的学习、创新和沟通协调能力，具有团队互助精神。 2. 能熟练查找阅读分析中英文设备资料，有自主分析解决问题的能力。 3. 了解半导体工艺制程，具有无尘室工作经验优先，具有设备维修工作经验优先。 4. 学历本科以上，年龄35岁以下优先，机电相关专业。</p>	icachr@ime.ac.cn
先导中心	刻蚀设备工程师	机电相关专业	<p>岗位职责： 1. 刻蚀设备维护、维修：依据设备规范及时进行设备的维护及保养工作，保障设备稳定运行。 2. 设备维修：对设备出现的故障及时维修处理，提升设备uptime。 3. 设备备件采购：定期检查易耗件库存并提前采购，做好costdown。 4. 兼任部门安全员，负责设备相关区域6S。定期进行安全巡检，及时排除安全隐患，出现安全事故按照应急流程及时进行处理。 5. 设备相关的质量文件完善、编制、培训。</p> <p>岗位要求： 1. 工作态度认真负责，积极主动，有较强的学习、创新和沟通协调能力，具有团队互助精神。 2. 能熟练查找阅读分析中英文设备资料，有自主分析解决问题的能力。 3. 了解半导体工艺制程，具有无尘室工作经验优先，具有设备维修工作经验优先。 4. 学历本科以上，年龄35岁以下优先，机电相关专业。</p>	icachr@ime.ac.cn

2025年度微电子所招聘岗位一览表

部门	岗位名称	专业	岗位职责及岗位要求	简历接收邮箱
先导中心	工艺整合工程师	集成电路制造；微纳加工；光学工程材料学；等离子体物理；化学；机械	<p>岗位职责：负责集成电路前段整合工艺设计与开发、流片与电学测试，分析、解决流片过程中遇到的各类工艺、器件结构、电学特性等异常问题；撰写研发报告。完成部门领导布置的其他任务。</p> <p>岗位要求：熟悉集成电路版图设计、制造工艺（晶体管制造）与电学测试；具有较强逻辑思维能力和独立分析问题、解决问题能力；工作认真负责，具有较好的团队合作能力和协同沟通能力；可以查找、阅读英文文献，具有较强的文字表达能力。具有一定工作经验更佳。</p>	icachr@ime.ac.cn
先导中心	工艺研发工程师	集成电路制造；微纳加工；材料学；等离子体物理；化学；机械	<p>岗位职责：负责超平坦化工艺开发、短流程流片与超平表面测试表征方法研究等。分析、解决工艺开发过程中遇到的各类工艺问题；撰写研发报告。完成部门领导布置的其他任务。</p> <p>岗位要求：熟悉化学机械平坦化工艺、干法刻蚀工艺以及扫描电子显微镜、原子力显微镜、激光干涉仪等物理表征手段；具有较强逻辑思维能力和独立分析问题、解决问题能力；工作认真负责，具有较好的团队合作能力和协同沟通能力；可以查找、阅读英文文献，具有较强的文字表达能力。具有一定工作经验更佳。</p>	icachr@ime.ac.cn
先导中心	新型互连研发	微电子相关专业	<p>岗位职责：</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 开展三维器件新型互连研发工作并协助完成模块在器件中的集成及兼容性验证，包括结构设计、仿真、制备及测试分析； 2. 把握国内外研究现状和发展趋势，申报所属领域的科研项目； 3. 参与相关项目的研究工作，撰写相应科研报告，并在重要学术期刊上发表高水平论文； 4. 指导和协助指导研究生。 <p>岗位要求：</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 博士研究生毕业，具备半导体物理等相关知识背景； 2. 具有集成电路制造相关工艺经验，尤其是硅基MOS器件工艺基础； 3. 掌握器件仿真、参数及特性分析的相关软件的使用，并能完成相关测试分析； 4. 能利用外语独立开展国际交流，具备撰写出较高水平的研究报告或发表过较高学术价值的论文的能力。 	icachr@ime.ac.cn

2025年度微电子所招聘岗位一览表

部门	岗位名称	专业	岗位职责及岗位要求	简历接收邮箱
先导中心	三维硅基MOSFET器件集成	微电子相关专业	<p>岗位职责：</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 开展三维器件集成研发，包括结构设计、仿真、制备及测试分析； 2. 把握国内外研究现状和发展趋势，申报所属领域的科研项目； 3. 参与相关项目的研究工作，撰写相应科研报告，并在重要学术期刊上发表高水平论文； 4. 指导和协助指导研究生。 <p>岗位要求：</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 博士研究生毕业，具备半导体物理等相关知识背景； 2. 具有集成电路制造集成经验，尤其是硅基MOS器件工艺基础； 3. 掌握器件仿真、参数及特性分析的相关软件的使用，并能完成相关测试分析； 4. 能利用外语独立开展国际交流，具备撰写出较高水平的研究报告或发表过较高学术价值的论文的能力。 	icachr@ime.ac.cn
先导中心	光电集成研究博士后	光电集成相关专业	<p>岗位职责：负责跟踪硅光发展趋势和前沿研究，负责硅基光电集成芯片的前沿研究，负责或参与无源或高速硅基光电子器件研究、SOI等多种材料光电器件与芯片理论分析、设计、版图；负责或参与光电集成芯片的研究探索；参与硅光项目申请与实施。</p> <p>岗位要求：1. 博士学位，EE及光电子等相关专业，35岁以下优先。 2. 有SOI无源和高速光器件与芯片设计与流片经历优先。3. 熟悉Lumerical等光电子仿真设计软件及版图软件。 5. 工作态度积极，责任心强，执行力强，能独立承担研究课题的主要研究任务。6流利的英语读写能力。</p>	icachr@ime.ac.cn
光电中心一组	光学工程师	1) 光学类专业； 2) 光学工程专业	<p>岗位职责：</p> <ol style="list-style-type: none"> (1) 负责精密光学设计和微纳检测技术研究，包括照明光学系统设计、超分辨成像光学设计、光束匀化整形、偏振调制、纳米级特征光学衍射/散射仿真等； (2) 复杂光学系统搭建与装调、光学器件选型与采购； (3) 撰写技术报告、调研相关英文文献； (4) 上级安排的其它任务； <p>岗位要求：</p> <ol style="list-style-type: none"> (1) 熟练使用Zemax或CodeV等光学设计软件；熟练使用Matlab数据分析工具； (2) 具有扎实的工程光学理论基础；能够熟练使用英文进行文献查阅、文章撰写； (3) 熟悉各种光学显微镜原理，具备微纳光学系统设计和搭建经验者优先； (4) 做事踏实细心、积极主动、认真负责； 	yaoyu2020@ime.ac.cn

2025年度微电子所招聘岗位一览表

部门	岗位名称	专业	岗位职责及岗位要求	简历接收邮箱
光电中心一组	嵌入式开发工程师	1) 信息与电子科学类 2) 控制科学与工程类专业 3) 光学工程类	<p>岗位职责：</p> <p>(1) 嵌入式硬件开发、新型嵌入式架构设计及优化；</p> <p>(2) 数据采集及信息综合处理；</p> <p>(3) 高速测距及图像信息处理及算法实现；</p> <p>岗位要求：</p> <p>(1) 熟练掌握至少一种常用的PCB设计软件，能够独立进行电路设计；</p> <p>(2) 掌握信号处理理论与方法，具有较为扎实的嵌入式软硬件设计、调试及开发经验；</p> <p>(3) 熟练掌握C、Verilog硬件编程语言，具有一定的FPGA或GPU或DSP应用经验；</p> <p>(4) 具有高速信号处理、激光测距开发经验者优先；</p> <p>(5) 具有较强的学习能力和责任心，具有团队合作精神和良好的沟通能力。</p>	yaoyu2020@ime.ac.cn
光电中心一组	光学测量及软件研发工程师	1) 仪器科学与技术类专业 2) 光学工程类专业 3) 计算机科学与技术类专业软件工程专业	<p>岗位职责：</p> <p>光电测量算法、软件研发、模型设计、测量流程设计与实现。</p> <p>岗位要求：</p> <p>(1) 具备扎实的数学功底，掌握几何量测量基本理论知识，系统学习过机器视觉、误差理论、机器人运动学、光电检测技术等课程者且成绩优秀者优先；</p> <p>(2) 具有较强的编程实操能力，能够熟练使用C/C++，c#，Python等语言进行项目开发，熟悉OpenCV、Qt、VTK、tensorflow、pytorch等框架；</p> <p>(3) 在公开数据集或软件系统开发方面取得显著成绩或具有丰富开发经验者优先；</p> <p>(4) 具有良好的沟通表达和问题分析能力，独立或主导过软件应用需求分析、软件文档编制者优先。</p>	yaoyu2020@ime.ac.cn
光电中心一组	综合测试工程师	1) 光学类专业； 2) 光学工程专业 3) 信息与电子类专业 4) 自动控制类专业	<p>岗位职责：</p> <p>(1) 激光器、准直器件、耦合器件、光学部件高效测试方法与工艺研究；</p> <p>(2) 电路PCB绘制与改进、高速电路板性能评估与测试；</p> <p>(3) 精密转台测试、转台热学仿真测试、光栅测角性能评估；</p> <p>(4) 几何量仪器综合测试方案规划，坐标、测量姿态测量方法研究。</p> <p>岗位要求：</p> <p>(1) 具有光学工程、仪器科学与技术、电子科学与技术、自动控制等相关专业背景；</p> <p>(2) 具有较好的动手能力，能够熟练使用数据分析软件用MABLAB, C/C++等；</p> <p>(3) 上述条件符合两条以上，具有测试系统开发经验者优先；</p>	yaoyu2020@ime.ac.cn

2025年度微电子所招聘岗位一览表

部门	岗位名称	专业	岗位职责及岗位要求	简历接收邮箱
光电中心二组	高压电源及电路设计	电气工程自动化	<p>岗位职责：</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) 开展高压电源设计与研制； 2) 放电电路设计与研制； 3) 配合完成系统集成实验验证及样机研制工作。 <p>岗位要求：</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) 具备扎实的电气工程等专业基础知识和较为丰富的项目研发实践经验，具有较强的独立研发工作能力，认真负责，勤勉踏实，善于沟通，富于团队协作。 2) 年龄35岁以下优先，硕士及以上学历。 3) 专业为电气工程自动化等，着重脉冲高压电源及气体放电电路设计，有扎实的模拟电路、数字电路基础，熟悉功率电子器件参数性能和使用方法。 4) 熟练掌握电气仿真软件如PSIM、Pspice、Altium Designer等至少一种，可完成电源电路的模拟分析。 5) 具有高压（kV级）电源电路设计开发经验，熟悉电源拓扑结构，有工作经验者优先。 	hanxuerong@imc.ac.cn
光电中心二组	光学工程师	光学工程、光学、仪器科学与技术、物理及相关专业	<p>岗位职责： (1)精密光学系统理论与方法研究；(2)精密光学系统集成与测试；(3)新原理光学系统研究与设计。</p> <p>岗位要求： (1)光学工程、光学、仪器科学与技术、物理及相关专业；(2)具有VirtualLab物理光学建模仿真经验者优先；(3)具有干涉仪、精密仪器相关开发经验者优先；(4)善于沟通，良好协调能力和团队合作精神。</p>	hanxuerong@imc.ac.cn
光电中心二组	电控工程师	电气工程、电工、控制类专业	<p>岗位职责：</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) 光电类设备电控系统研发，包括电控系统设计、软件编程、图纸绘制、生产过程跟踪及控制等。 2) 电控系统装配、调试及其工艺控制，制定操作流程，运行维护等。 3) 与光学、热控、机械等专业研发人员协同工作。 4) 电控系统研发相关技术文档编写。 <p>岗位要求：</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) 可利用专业理论知识开展电控系统设计和研发工作。 2) 掌握Solidworks、AutoCAD等制图软件。 3) 可利用组态王等软件开展电控软件设计。 4) 掌握C++程序设计及MATLAB编程等。 	hanxuerong@imc.ac.cn

2025年度微电子所招聘岗位一览表

部门	岗位名称	专业	岗位职责及岗位要求	简历接收邮箱
光电中心二组	机械工程师	机械设计、 机械工程、 机械制造及其 自动化等 相关专业	<p>岗位职责： (1)、超精密机械结构原理方案设计、仿真分析及实现； (2)、精密机械系统热仿真与振动仿真； (3)、精密机械系统集成与测试；</p> <p>岗位要求： (1)、熟练使用Solidworks、Ansys等机械设计、仿真软件，能够进行公差分析、力学仿真、强度分析、热分析、振动分析等； (2)、深入了解精密机械加工工艺者优先； (3)、具有精密仪器机械结构设计、静力学和动力学仿真分析经验者优先； (4)、善于沟通，良好协调能力和团队合作精神。</p>	hanxuerong@imc.ac.cn
光电中心三组	光子集成设计 工程师	光学工程、 信息工程等 相关专业	<p>岗位职责：光子集成设计、开发、测试</p> <p>岗位要求： (1) 信息与通信工程类、光学工程类相关专业，硕士及以上学历； (2) 良好的团队沟通及团队协作能力； (3) 具有良好的半导体激光器、集成光子芯片、混合集成激光器等专业知识； (4) 具有Crosslight (Pics3D、Lastip)、Rsoft、COMSOL、FDTD Solution、COMSOL、Matlab、Python、Tensor等有源和无源芯片的设计、光路仿真、电学和热学性能仿真等集成光子芯片一体化设计经验和能力者优先； (5) 有较强的设计仿真与实验动手能力，熟悉光子集成工艺优先。</p>	qiaozhi@ime.ac.cn
光电中心三组	软件工程师	光学工程、 信息工程等 相关专业	<p>岗位职责： 1. 研究激光雷达关键技术，追踪激光雷达技术发展趋势； 2. 参与设计激光雷达系统及其相关光学器件的选型； 3. 负责激光雷达系统的搭建与调试；</p> <p>岗位要求： 1. 学历要求：已获得或即将获得博士学位，具有光学（光学、光学工程、光电子）或半导体（半导体、微电子、集成电路）相关专业背景之一； 2. 熟悉激光雷达系统工作原理以及基本结构； 3. 熟悉信号理论处理理论与方法； 4. 做事踏实细心、积极主动，具有团队合作精神和良好的沟通能力。</p>	qiaozhi@ime.ac.cn

2025年度微电子所招聘岗位一览表

部门	岗位名称	专业	岗位职责及岗位要求	简历接收邮箱
光电中心四组	激光技术	光学	<p>岗位职责：激光光源相关实验研究</p> <p>岗位要求：博士及以上学历，具有等离子体物理、激光技术、光学、激光与物质相互作用等专业背景；具有良好的中英文读写能力。</p>	cuihuirong@aoe.ac.cn
光电中心四组	微纳光子器件研发工程师	微纳光学、光子集成	<p>岗位职责：光子集成、超构光学器件设计；</p> <p>岗位要求：博士及以上学历，具有物理光学、硅光子集成器件或超构光学器件等方向研究经验，能熟练使用Lumerical、CST或Comsol进行微纳光子器件设计；具有良好的中英文读写能力。</p>	cuihuirong@aoe.ac.cn
新技术开发部存储器实验室	先进工艺芯片设计工程师	微电子或相关专业	<p>岗位职责：先进工艺芯片设计-数字或模拟方向</p> <p>岗位要求：</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 掌握集成电路设计流程，熟练使用vcs/verdi等数字电路仿真工具或熟练使用Virtuoso/Spectre/calibre等EDA工具进行电路设计、仿真实验验证，版图设计； 2. 具有数字电路芯片(ASIC)RTL/综合/STA等开发经验或OPA、LDO、Bandgap、OSC等模拟模块设计经验； 3. 初步具备数字或模拟电路设计及使用相关EDA工具开发的能力； 4. 兼有FPGA开发经验者优先；兼有UVM验证经验者优先；兼有先进工艺芯片开发经验者优先；兼有存算一体芯片开发经验者优先；兼有混合信号电路设计和测试经验优先； 5. 工作有主动性，具有责任感和团队合作的意识。 	wangsining@ime.ac.cn
新技术开发部存储器实验室	存储系统固件开发工程师	微电子/计算机/通信/自动化或相关专业	<p>岗位职责：存储系统固件开发，FTL及闪存近存算法设计</p> <p>岗位要求：</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 掌握存储系统固件开发流程，熟练掌握C语言； 2. 具有嵌入式系统开发经验，了解精简指令集； 3. 初步具备ARM、RISC-V等固件开发能力； 4. 兼有FPGA固件开发经验者优先；兼有FTL开发经验者优先；兼有近存计算开发经验者优先；兼有了解存储系统架构者优先； 5. 工作有主动性，具有责任感和团队合作的意识。 	wangsining@ime.ac.cn

2025年度微电子所招聘岗位一览表

部门	岗位名称	专业	岗位职责及岗位要求	简历接收邮箱
新技术开发部 存储器实验室	新结构3D NAND闪存器件 基础研究	微电子学与 固体物理 学, 应用物 理学, 电子 科学与技术, 集成电路	岗位职责: 1. 主要负责课题组半导体器件设计, 尤其是新型存储器器件构架设计; 2. 主要负责完成半导体先导工艺研发与优化; 3. 完成半导体器件研发, 尤其是新型存储器器件工艺整合及优化; 4. 半导体器件电学性能测试与分析; 5. 半导体器件可靠性性能测试与分析; 6. 完成领导交办的其他任务。 岗位要求: 1. 物理学、微电子学相关专业; 2. 熟练半导体器件及存储器器件基本原理; 3. 具备半导体工艺研发经验者优先; 4. 具备半导体生产线、研发线, 尤其是8/12inch生产线、研发经验者优先; 5. 工作有主动性, 具有责任感和团队合作的意识。	wangsining@ime.ac.cn
新技术开发部 光刻测控组	电控工程师	电路与系统 、自动化等 相关专业	岗位职责: 1、电控系统的设计、开发和集成。 2、系统控制软件的设计和开发。 3、信号处理、数值分析、运动控制等实时算法开发。 4、协助开展科研项目申报、实施、结题等工作 5、协助开展电控系统关键技术开发, 撰写相关文档。 6、专利、软件著作权和学术论文的申请和发表。 岗位要求: 1、电路与系统、自动化等相关专业, 博士学历。 2、熟悉C#和C++语言, 掌握Visual Studio等开发工具。 3、熟悉常用系统总线和通信协议。 4、掌握常用的实时算法, 例如: 信号处理、数字滤波、运动控制等。 5、熟悉半导体制造装备的基本工作原理。 6、具有良好的英文读写能力。	pom@ime.ac.cn

2025年度微电子所招聘岗位一览表

部门	岗位名称	专业	岗位职责及岗位要求	简历接收邮箱
新技术开发部 光刻测控组	光刻技术	物理学、光学、光学工程等	岗位职责： 在光刻套刻对准、对焦技术方向，根据先进工艺需求构建相关模型，开发相应的仿真分析工具，开展光刻工艺的优化。 岗位要求： 1) 知名高校、科研院所取得博士学位不超过3年，应届毕业生优先； 2) 年龄一般不超过35周岁； 3) 具有物理学、光学、光学工程等相关专业背景； 4) 掌握干涉测量、光栅、偏振照明等理论，熟悉算法和软件开发，具有光刻方向研究经验者优先考虑。 5) 恪守科研道德和学术规范，学风正派、诚实守信，具有较强的科研创新潜力和团队协作精神。	pom@ime.ac.cn
新技术开发部 光刻测控组	嵌入式软件和算法工程师	计算机、电子、通信、自动化等相关专业	岗位职责： 基于DSP和VxWorks等平台的电控系统嵌入式软件和相关算法开发，电控系统集成和联调。 岗位要求： 1) 计算机、电子、通信、自动化等相关专业，硕士及以上学历，至少2年工作经验。 2) 熟悉TI 6000系列DSP产品，了解DSP内部架构，熟练掌握C语言、TI CCS的开发和调试方法。 3) 熟悉PCI/PCIe、VME/VPX、SRIO等总线协议，熟悉TCP/IP、高速串行等通信协议。 4) 有VxWorks和RTOS开发经验者优先。 5) 具有良好的英文读写能力。	pom@ime.ac.cn